

山东天岳先进科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称:天岳先进

证券代码:688234.SH/02631.HK

编号:2026-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话调研 <input type="checkbox"/> 其他 _____
活动主题	天岳先进 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会
时间	2026-05-19 - 16:00-17:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动
参会人员	董事长、总经理:宗艳民 独立董事:李洪辉 财务负责人:游樱 董事会秘书:钟文庆
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分:交流环节的主要问题及回复 问题 1:您好,我注意到公司 2025 年财报披露,主营业务毛利率同比减少 15.82%;其中,境内毛利率降为-6.22%,同比减少了 27.01%。请问毛利率下降的主要原因是? 2026 年毛利率能否改善? 国内产品毛利,能否转正? 回复: 尊敬的投资者,您好! 在行业阶段性竞争加剧的背景下,公司为了巩固核心客户的战略合作、提升市场份额并加速下一代产品的渗透,在价格端进行了动态统筹,从而导致了去年的毛利率在财务表现上有所承压。 2026 年第一季度,公司的各项优化措施已经开始实质性显效,公司毛利率较 2025 年第四季度环比大幅改善了

25%，主要得益于公司一季度同步推进的经营策略调整、生产技术升级。通过工艺优化和良率提升实现了核心产品成本的实质性下降，同时全面推行精细化管理优化了内部运营效率。展望 2026 年全年，公司整体的战略导向将更加聚焦于盈利能力的增长。随着一季度改善，需求端持续放量，公司技术升级和降本增效也将逐步体现。具体请关注公司后续有关报告。感谢您的支持与关注！

问题 2：您好，我想询问目前 12 英寸的 Sic 衬底在台积电的测试究竟验证通过没有，目前市场对这件事的小作文很多，其次这次的测试到底是用于未来的中介层还是散热版，还有就是假如要用到先进封装，目前 N 型导电型 8 英寸的售价以及成本到底是大概多少？

回复：尊敬的投资者您好，相关情况请您以公司发布的公告为准。感谢您的理解与支持！

问题 3：董事长您好，我想请问您预计今年碳化硅衬底的供需结构和价格趋势会如何？

回复：尊敬的投资者，您好！碳化硅衬底的需要按照应用级别（车规级与非车规级）进行分层看待。两者的技术门槛、质量控制以及整体的供应难度存在着较大差异。车规级衬底技术壁垒极高，始终保持供需平衡，汽车领域对半导体器件的零缺陷（Zero Defect）、高可靠性、耐高温高压等要求苛刻。因此车规级碳化硅衬底的整体供应难度非常大，不仅要求在上游晶体生长中控制极低的缺陷密度，还需要通过下游功率半导体头部厂商及整车厂严苛的认证。目前全球范围内真正能够实现车规级衬底、尤其是高端大尺寸（如 8 英寸）产品稳定量产和规模化交付的供应商数量较少。因此，车规级市场一直以来都保持着非常健康的供需平衡状态。非车规级衬底的应用领域主要在诸如在光伏、储能、工业以及消费电子等非车规级应用领域，虽然其供应难度同样显著高于传统硅基材料，但相较于车规

级而言门槛略低。在过去几年的行业快速发展中，该细分领域经历了一轮阶段性的格局调整，当前非车规级行业的供需结构目前正在逐渐出清。缺乏核心技术、规模效应和质量优势的低效产能被加速淘汰，市场份额正快速向具备技术代差和成本控制能力的头部企业集中。随着供需关系的实质性改善和渠道库存的消化，目前非车规级衬底的价格也已经整体企稳，行业正在回归到健康、理性的新常态。总体来说，全球碳化硅衬底行业正在走向分化。公司作为行业领军企业，战略重心始终聚焦于高壁垒、高附加值的车规级市场以及下一代大尺寸产品的迭代。产品结构方面的优势，使得公司在行业整体步入新周期的之后，具备更强的抗风险能力和更大的发展弹性。感谢您的支持和关注！

问题 4: 1. 请您介绍一下行业竞争格局，目前天岳和 wolfspeed 之间是否有差距，还是已经吃掉其市场份额。 2. 关于 citirni 近期报告和市场由火爆到近几日回调，您怎么看，ai 数据中心电源架构全面升级，是否真的会带来行业质的飞跃，这个体量的变化今年能看到么。 3. 目前市场供需是否已经开始扭转，反映到企业财报上何时才能体现。 4. 您觉得目前公司价值合理么，你们会考虑回购么。

回复：尊敬的投资者，您好！一、行业竞争格局及市场地位 从竞争格局看，根据富士经济发布的报告，2025 年全球导电型碳化硅衬底材料市场中，天岳先进市场份额为 27.6%，位居全球第一；其中 6 英寸市场份额为 27.5%，8 英寸市场份额 51.3%。从 2023 年 12% 的市场份额起步，公司两年间实现跨越式发展，行业集中度持续提升，公司已成为全球碳化硅衬底领域的领军企业。公司与所有客户开展的合作均遵守双方合同约定和相关法律规定，未经许可不得公开具体客户信息，如合作达到披露标准，公司将及时公告。二、关于市场报告及行业应用进展 公司关注到近期有研究报告就碳化硅材料在高压电源等场景的应用进行了分析，但不具体报告内容作

出评价。公司始终认为，碳化硅衬底在大尺寸化、高效率应用方向上拥有较好的发展空间，公司也正围绕该方向持续优化产品布局、推进客户合作，致力于提升经营成果。三、市场供需与财报体现 从公司观察来看，2025 年公司碳化硅衬底销量 63.33 万片、同比增长 75.33%，产销量快速增长。今年各工厂产能稼动率保持在合理水平，整体运营平稳。具体经营情况请关注公司定期报告。四、估值与回购计划 公司管理层始终对公司发展充满信心，相关情况请以公司发布的公告为准。感谢您对公司的关注和支持。

问题 5：请问财务总监，根据公司一季度财务报表，为什么公司账户上有 20 多亿现金的情况下，还增加了 2 亿多元的银行借款，这不是增加财务成本吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司一季度账面货币资金 31.54 亿元，其中包含港股募集资金、项目专户资金、票据保证金等专项用途资金。本期新增银行借款合计 1.78 亿元，其中 1.43 亿元短期流动资金贷款，主要用于原材料备货、日常经营周转；0.35 亿元长期借款专项用于大尺寸碳化硅项目产能扩建。目前市场融资利率整体偏低，适度合理举债，既稳固银企合作、预留充足授信空间，也匹配项目建设节奏。本次新增借款带来的财务费用体量较小，对公司整体经营业绩影响有限，均为公司统筹资金规划下的合理安排。感谢您的关注！

问题 6：您好，我注意到贵公司在 2024 年及本次均未采用直播形式的业绩说明会并提供视频回放。请问在 2025 年的业绩说明会中，贵公司是否考虑引入视频直播形式，并在会后提供完整的视频回放，以便投资者更充分地了解会议内容？感谢您的解答。

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司业绩说明会的关注以及提出的宝贵建议。公司始终高度重视与投资者的沟通交流，关于您在建议中提到的视频直播及回放形式，公司已收悉并将认真考虑。后续业绩说明会的具体安排，请以公司发布的公告为准。感谢您的

关注！

问题 7： 请问国内碳化硅产业是否存在内卷式竞争的问题？产业发展趋势如何？作为龙头企业，如何保证产品的竞争力和产业的合理利润？

回复：尊敬的投资者您好，过去两年碳化硅衬底行业经历了较为充分的价格调整，目前来看，6 英寸产品价格已逐步进入相对稳定区间，8 英寸产品仍在以市场化方式推动渗透，但整体价格明显企稳。目前行业正从此前的价格快速调整阶段，逐步转向“价格趋稳、需求扩容”的新阶段。公司将坚持价值定价，综合产品尺寸、质量、服务内容与长期战略保供能力，与客户建立以性能与可靠性为基础的长期合作关系，杜绝内卷式的价格博弈，重视客户满意度、良率与交付时效，并通过工艺进步和精益制造确保降本增效工作的顺利展开，并以内生性盈利支撑持续研发和智能工厂迭代投入，有力提升经营质量。感谢您的关注与支持！

问题 8： 请问董事长，根据公开报道，济南先进材料智造港已于 2025 年下半年建成，12 月份投产，但是公司一直没有宣传过该基地的情况。请问该基地是否为公司的基地，目前具体情况如何，什么时候可以投产？

回复：尊敬的投资者您好，相关情况请以公司在指定媒体发布的公告为准，感谢您的理解与支持。

问题 9： 领导您好，我有三个问题想请教下：1) 请问公司 8 英寸碳化硅衬底是否直接或间接供应 SST 公司，类似台达和伊顿？；2) 公司目前业务涉及 AI 数据中心领域的收入占比有多少？今年预计增速如何？3) 公司到 2026 年年底 8 英寸和 12 英寸的产能各有多少？预计良率能达到多少？行业水平是多少？谢谢

回复：投资者您好，三个问题回复如下： 1、公司的核心产品是

碳化硅衬底，属于产业链最上游的核心关键材料；衬底交付后，需经过外延生长，再由下游的功率器件厂商加工制造成为 SiC 芯片或器件；最后，由像 SST、如您所说的台达、伊顿这样的电源模块及系统集成商，将器件封装集成到最终的电源模块中，应用到数据中心或新能源领域。基于上述产业链结构，公司一直深度聚焦于全球顶尖半导体企业的合作。目前，在全球前十大功率器件厂商当中，超过一半已经是公司的直接客户。基于商业保密协议及合规要求，我们不便披露具体客户的名称。而您提到的 SST 公司作为下游电源模块厂商，公司与其无直接供应关系。值得强调的是，在行业向 8 英寸转型升级的关键节点上，公司展现出了极强的核心竞争力。目前，公司在全球 8 英寸碳化硅衬底的市场占有率已经超过了 50%。2、关于 AI 数据中心领域的收入占比及具体增速，属于公司未公开披露的经营细节，请以公司发布的定期报告为准。3、公司采用“多地协同、技术联动”的产能布局策略，上海临港与济南工厂高效协同，稳步推进大尺寸碳化硅衬底产能建设。截至目前，公司 8 英寸产品已实现稳定批量供应，通过持续工艺精进与制造效率提升，产品良率与质量稳定性处于行业领先水平。12 英寸碳化硅衬底研发及产业化工作正按计划有序推进。关于具体产能规划及良率数据，公司将紧密围绕市场需求和订单变化，秉持“精准规划、分步实施”的原则分阶段释放产能。行业内不同企业因技术路线、产线成熟度及工艺积累不同，良率水平存在一定差异。公司后续产能建设及经营进展情况，将通过定期报告及临时公告及时向市场披露。感谢您对公司的关注和支持！

问题 10： 贵公司的 SiC 产品有使用在电动汽车上面吗？国内的汽车厂商哪些是贵公司的客户？

回复：投资者您好，公司的碳化硅衬底可广泛应用于新能源汽车、AI 数据中心、光伏系统、AI 眼镜、轨道交通、电网、家电及先进通信基站等领域。在新能源汽车及功率器件领域，公司持续服务全

	<p>球领先客户。公司已与全球前十大功率半导体器件制造商中一半以上建立合作关系，并与国际客户形成长期稳定合作生态。</p>
--	---